

Our material technologies solved problems of rise in melting point, bonding strength degradation, and wettability decrease caused by low-silver & no-silver process

低銀&無銀化による、融点上昇/接合強度劣化/濡れ性低下を素材技術で解決

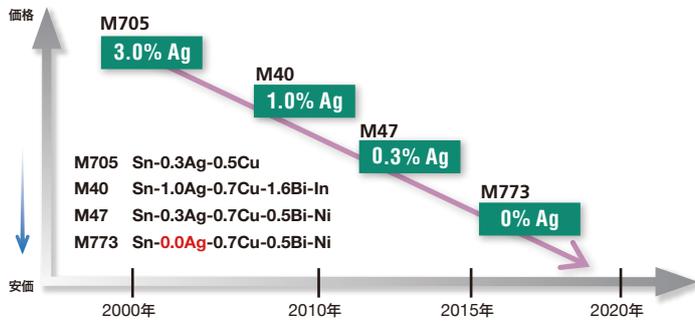
特長

- M705と同様な温度プロファイルで実装できる、M40
- 接合界面反応制御で落下衝撃性にも優れている、M47
- Bi, Ni の添加で、Sn-Cu系はんだの接合信頼性を向上した、M773
- 低銀、無銀専用フラックス LS720Vでボイドを低減



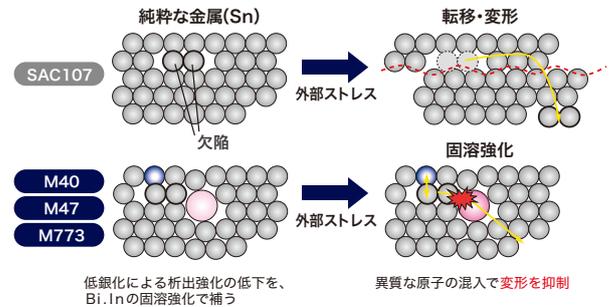
仕様

- 低銀&無銀はんだ合金で、低価格化を実現



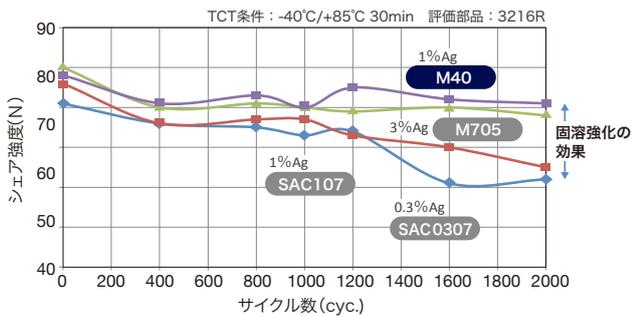
- 低銀化による析出強化の低下を、固溶強化で補う

Biの添加による固溶強化で、Snを強化



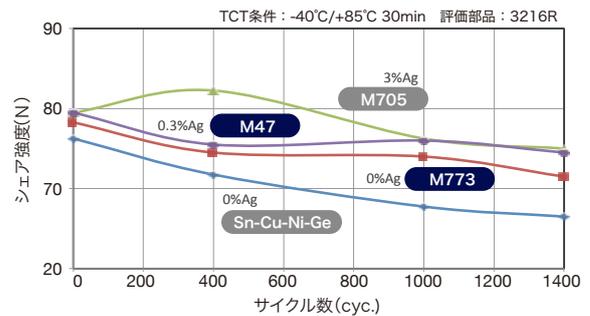
- 固溶強化を施したM40は、接合強度が高い

M40は、3%AgのM705よりも接合強度が高く、同じ1%AgのSAC107よりも大幅に高いことを確認

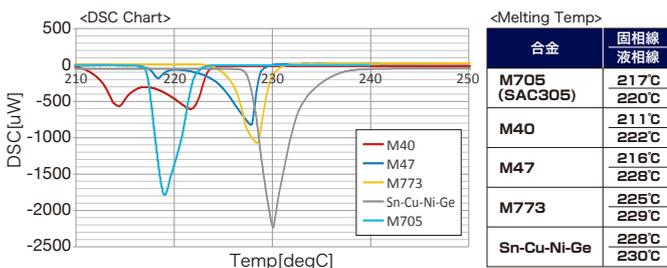


- 0.3%Agと0%Ag品に対する固溶強化の効果を確認

M40で効果を確認した固溶強化技術を、0.3%Agと0%Ag品にも応用
0%AgのM773は、固溶強化を施していないSn-Cu-Ni-Ge品よりも接合強度が高いことを確認



- M40は、M705と同じ温度プロファイルで実装可能



- M40/M47は、落下衝撃性に優れている

M47は、接合界面反応の制御により接合強度に加え、落下衝撃性にも優れている

